

# XPT2012 简介 2012年03月

XX 址: www.xptek.cn; www.xptek.com.cn 地 址:深圳市南山区科苑南路高新工业村 R3-A 座 5 楼 售: sales@xptek.cn 技术支持: support@xptek.cn 设计服务: design@xptek.cn



## **XPT2012**

### 芯片功能说明:

- XPT2012 是一款立体声、无滤波器、高效率、D类音频功率放大器。应用电路简单,只需要两个外部元器件即可以工作。采用 QFN 封装,非常节约电路面积,特别适合移动电话、掌上电脑及其他各种微型手持设备等低电压、低功耗应用方案上使用; XPT2012 可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗,并且两个通道可以分别独立控制。
- XPT2012 通过配置 G0 和 G1 引脚上的电平 ,可以调整增益为 6、12、18 或 24dB 其中的一 种; XPT2012 电源电压抑制比(PSRR)高,并 采用全差分结构,具有很强的噪声和射频干扰抑 制能力。

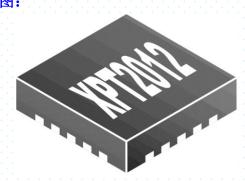
### 芯片功能主要特性:

- 高电源电压抑制比 (PSRR),在 217Hz 及 1KHz 时,达到 76dB
- 输出功率(Po)高(THD+N<10%):</li>QFN 封装:

5V 工作电压, 4Ω负载时, Po=2.1W×2 5V 工作电压, 8Ω负载时, Po=1.4W×2 3.6V 工作电压, 8Ω负载时, Po=720mW×2

- 宽工作电压范围: 2.5V-5.0V
- 工作电流电流小
- 掉电模式漏电流小
- 封装小, 节约电路面积: QFN
- 启动迅速 (3.5ms)
- 仅仅需要2个外围元件
- 增益可调整为 6、12、18 或 24dB;
- 两通道可以独立控制进入休眠模式
- 具有短路和过热保护机制
- 完全兼容 TPA2012D2

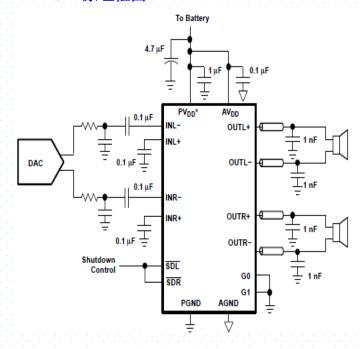
### 实物图:



### 芯片的基本应用:

- 移动电话(手机等)
- 手提电脑和 PDAs
- 便携 DVD 和收音机
- 便携游戏机
- 玩具
- USB 扬声器

### XPT2012 原理框图



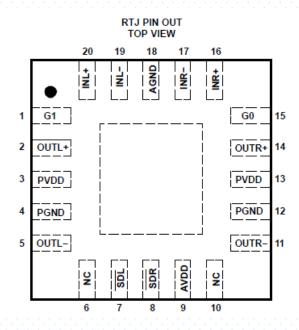
址: www.xptek.cn; www.xptek.com.cn 地址: 深圳市南山区科苑南路高新工业村 R3-A 座 5 楼售: sales@xptek.cn 技术支持: support@xptek.cn 设计服务: design@xptek.cn



## 芯片订购信息

芯片型号	封装类型	包装类型	最小包装数量(PCS)	备注
XPT2012QF	QFN	编带	3000/盘	带散热片

## XPT2012 的封装和引脚



## XPT2012 管脚描述 (QFN封装)

引脚				
名称	QFN	I/O	描述 	
INR+	16	I	右声道同相输入	
INR-	17	I	右声道反相输入	
INL+	20	I	左声道同相输入	
INL-	19	I	左声道反相输入	
SDR	8	I	右声道工作控制(低电平有效)	
SDL	7.	I	左声道工作控制(低电平有效)	
G0	15	I	增益选择 (LSB)	
G1	1	I	增益选择 (MSB)	
PVDD	3, 13	I	电源正端(必须与AVDD一样)	
AVDD	9	I	电源正端(必须与PVDD一样)	
PGND	4, 12	I	电源地	
AGND	18	I	电源地	
OUTR+	14	0	右声道正相输出	
OUTR-	11-1-1	, o o	右声道反相输出	
OUTL+	2	O .	左声道正相输出	
OUTL-	5	, o o	左声道反相输出	
NC	6, 10		空置	

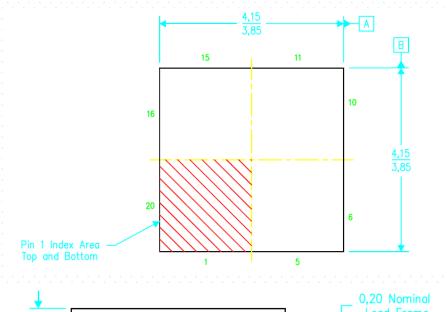
网 址: www.xptek.cn; www.xptek.com.cn 地 址: 深圳市南山区科苑南路高新工业村 R3-A 座 5 楼

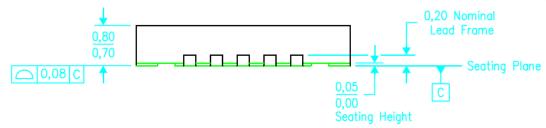
销 售: sales@xptek.cn 技术支持: support@xptek.cn 设计服务: design@xptek.cn

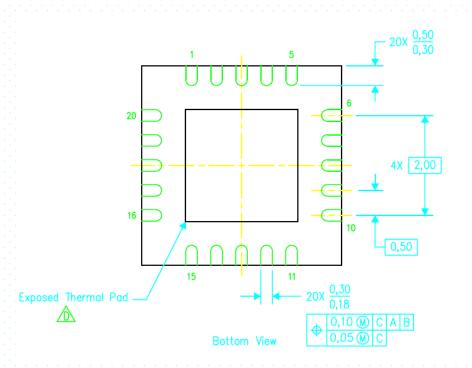


## 芯片的封装尺寸

### QFN20







### 当本手册内容改动及版本更新将不再另行通知,深圳市矽普特科技有限公司保留所有权利

址: www.xptek.cn; www.xptek.com.cn 地址: 深圳市南山区科苑南路高新工业村 R3-A 座 5 楼售: sales@xptek.cn 技术支持: support@xptek.cn 设计服务: design@xptek.cn